เชิญนักวิจัยไทย ส่งผลงานสู่เวทีโลก

ECWC17
Electronic Circuits World Convention

CALL FOR PAPERS

ECWC17 • 2027

17th ELECTRONIC CIRCUITS WORLD CONVENTION

Interconnection Technology for the AI-Driven Future

PCB, Substrate & Advanced Packaging



สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

18–20 สิงหาคม 2027 | BITEC กรุงเทพฯ

ส่งบทคัดย่อภายใน **1 กุมภาพันธ์ 2027**

ส่งบทความฉบับเต็มภายใน **23 เมษายน 2027**

8 TECHNICAL TOPICS

SHAPING THE FUTURE OF ELECTRONIC CIRCUITS

01	PCB manufacturing technology	05	Reliability, failure analysis & quality
02	Advanced packaging & semiconductor integration	06	Sustainability & green electronics
03	EMS, PCBA & system integration	07	Workforce development & education
04	Factory of the future & smart manufacturing	08	Emerging technologies

ดูรายละเอียดและส่งบทคัดย่อ submission-ecwc17.com/conferences/ecwc17

info@thpca.org | www.thpca.org/ecwc-17/

Hosted Organizer: THAILAND BOARD OF INVESTMENT
Organizer: THPCA
Co-located with: THAILAND ELECTRONICS CIRCUITS ASIA
Conference powered by: MUT, TMEC, EEPAT
Supported by: WECC, nxpo

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑GPCIY๓๖๗๔๔
URL https://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags